

# 한화인더스트리얼솔루션즈 2024년 3분기 실적발표

# Disclaimer

---

본 자료의 실적과 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 (잠정)자료로 외부 감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분들의 편의를 위하여 작성된 것으로 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다.

이러한 예측 정보는 이미 알려진 또는 아직 알려지지 않은 위험과 시장 상황, 기타 불명확한 사정 또는 당초 예상하였던 사정의 변경에 따라 영향을 받을 수 있고 실제 결과와 이에 기재되거나 암시된 내용 사이에 차이가 있을 수 있으며, 시장 환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 예고 없이 달라질 수 있습니다.

# 1. 2024년 3분기 실적발표

# 3분기 실적 (2024년 9월 한달 실적)

## ▼ 3Q24 손익계산서 (연결)

(단위 : 억원)

구분	3Q24 (9월)
매출액	1,395
매출원가	702
매출총이익	694
매출총이익률	49.7%
판매비와 관리비	413
연구개발비	227
영업이익	54
영업이익률	3.9%
영업외손익	-153 <sup>(*.2)</sup>
법인세차감전순이익	-99
법인세비용	32
당기순이익	-131
당기순이익률	-9.4%

## ▼ 주요내용

### ■ 24년 3분기(9월)

#### [시큐리티]

- 북미를 중심으로 구주, 아시아 전역에서 매출 증가세 지속

#### [산업용장비]

- 중화권 SMT 수요 회복 정체, 태양광설비 매출 증가 (YoY 9%)

#### [반도체설계]

- FPH<sup>(\*.2)</sup> 에서 개발 중이었던 서버용 NPU를 선택과 집중을 위해 청산 진행 중  
- 영업권 평가손실(125억) 발생

### ■ 24년 4분기

- FPH에서 개발중인 신규 SoC(WN9)개발 완료 후 상품화 진행중이며, 25년 1분기부터 지속적으로 신제품을 출시하여 한화비전 감시카메라 제품 경쟁력이 한단계 도약 될 것으로 전망됨

\*.1 한화인더스트리얼솔루션즈는 2024년 9월 1일 분할준속법인인 한화에어로스페이스(주)로부터 인적분할신설되었습니다. 이번 실적은 설립일 이후부터 9월 30일까지의 실적만 반영되었습니다.

\*.2 FPH (Fabless Pioneer Holdings / 반도체설계회사)

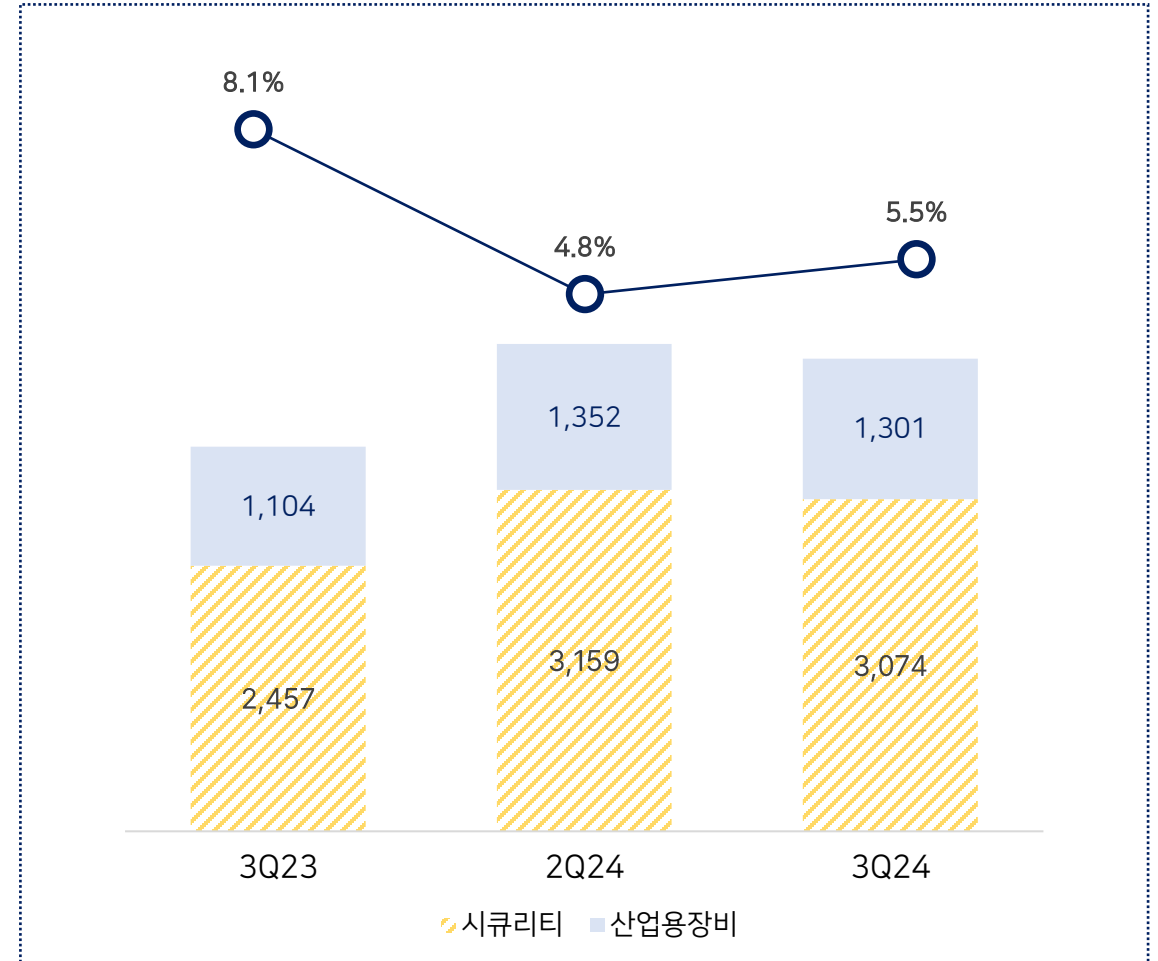
# 분할신설법인 추정손익 (비교 편의를 위한 조정실적)

» 한화인더스트리얼솔루션즈는 '24년 9월 1일 신설되어 그 이전 매출 및 이익은 존재하지 않습니다

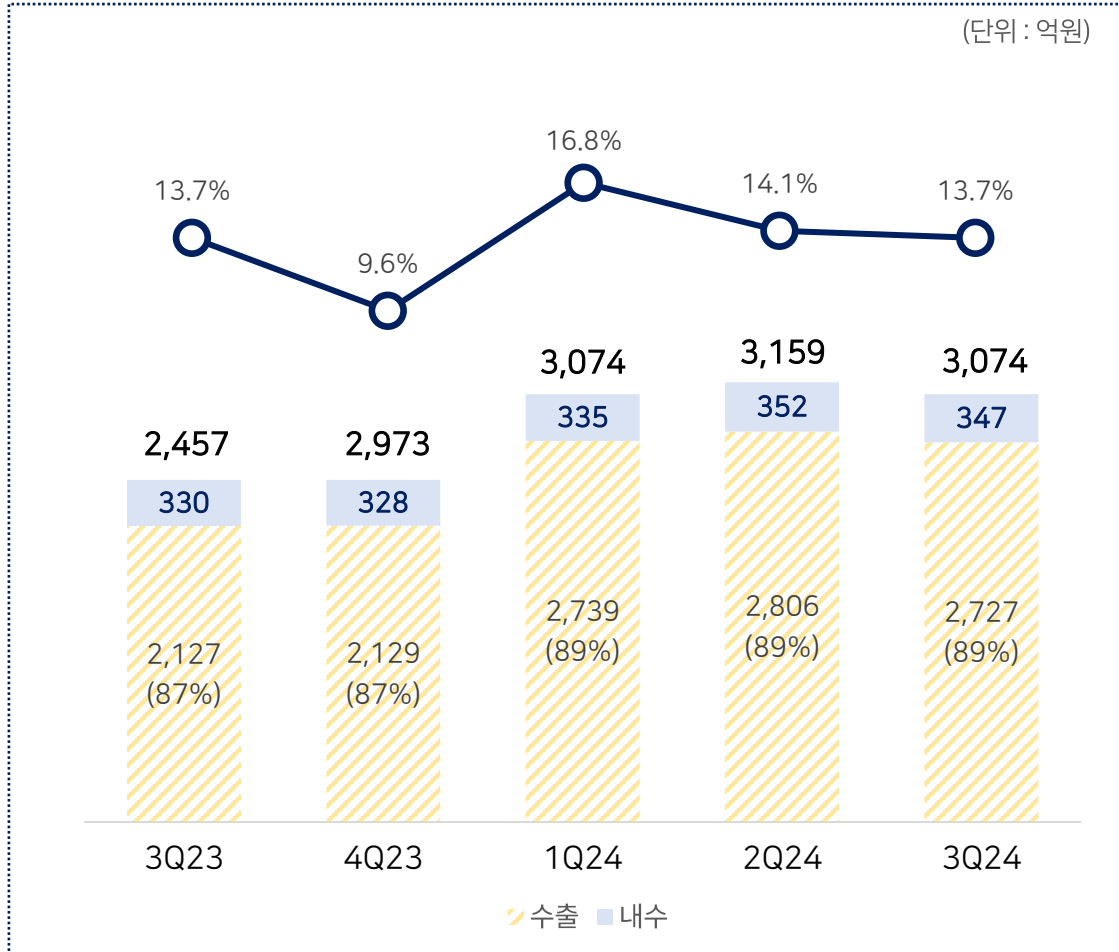
[투자자들의 이해를 돕고자 하기 실적은 분할 전 종속법인이 작성한 사업보고서 또는 IR자료 내 분할 신설예정 사업부과 그 종속법인의 매출 및 이익의 단순 합산입니다.]

## ▼ 주요 매출 및 영업이익

구분	3Q23	2Q24	3Q24	증감률	
				YoY	QoQ
매출액	3,564	4,511	4,375	22.8%	-3.1%
시큐리티	2,457	3,159	3,074	25.1%	-2.7%
수출	2,127	2,807	2,727	28.2%	-2.9%
내수	330	352	347	5.2%	-1.4%
산업용장비	1,104	1,352	1,301	17.8%	-3.8%
SMT	883	1,017	693	-21.5%	-31.9%
그 외 기타	221	336	607	174.7%	80.7%
반도체설계	3	-	-	-	-
영업이익 (%)	289	216	241	-16.6%	11.6%
시큐리티 (%)	8.1%	4.8%	5.5%	-2.6%p	0.7%p
산업용장비 (%)	337	446	420	24.6%	-5.8%
반도체설계 (%)	13.7%	14.1%	13.7%	0.0%p	-0.4%p
산업용장비 (%)	-14	-84	-49	적자확대	적자축소
반도체설계 (%)	-1.2%	-6.2%	-3.8%	-2.6%p	2.4%p
반도체설계 (%)	-34	-146	-131	-	-
반도체설계 (%)	-	-	-	-	-



## ▼ 분기별 매출 및 영업이익률



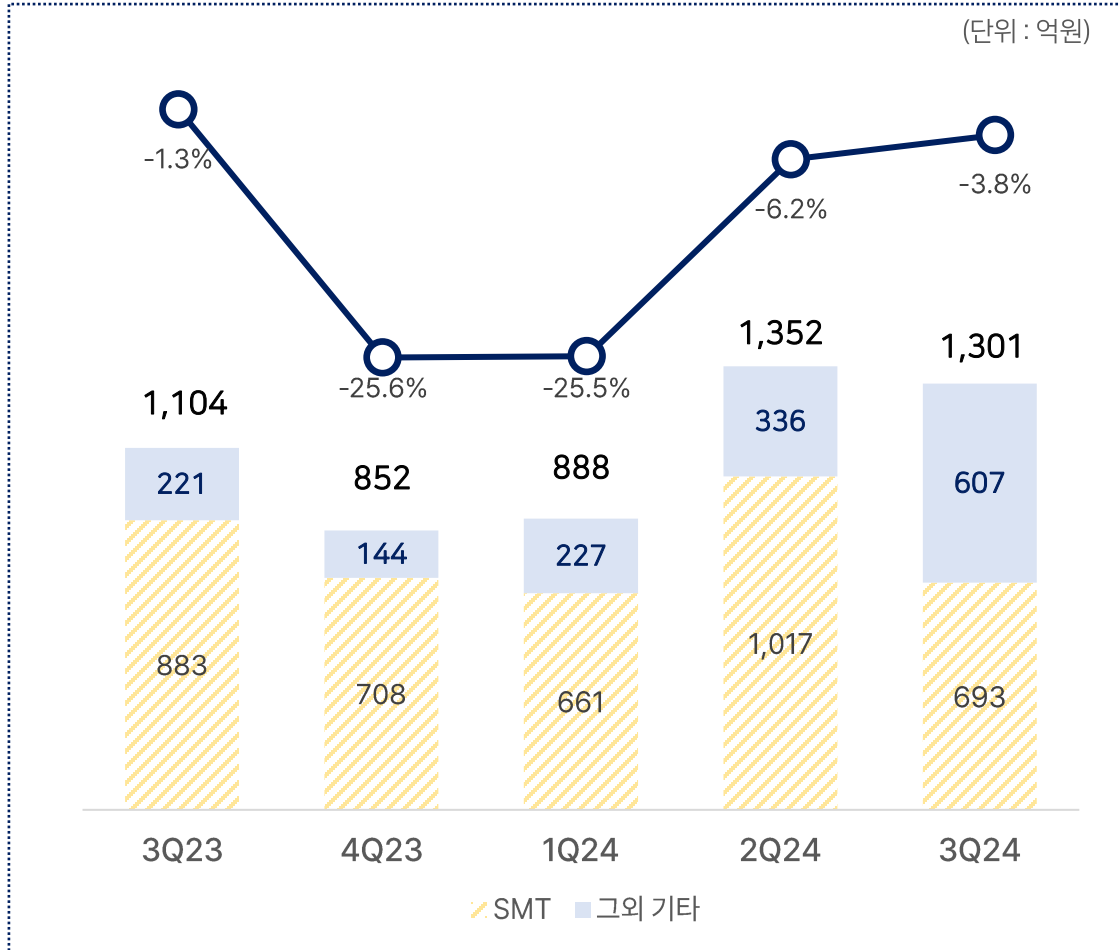
## ▼ 주요 내용

- 3Q24 매출액 3,074억원, 영업이익률 13.7% 달성
- AI기능 강화, 고객밀착 마케팅효과 강화되며 매출 증가
- '24년 10월, Cloud (DM Pro, Sight mind 등) 및 엔비디아 플랫폼 카메라 등 신제품 출시



- (미주) 지속적으로 감시장비 수요가 증가하고 있으며 AI 제품, Cloud 및 솔루션 출시
- (유럽) 선진시장인 영국/프랑스/독일 중심으로 시장 점유율 확대
- (국내) 지능형/산업안전 솔루션 공급 확대 및 대중소상생협력 사업 적극 대응

## ▼ 분기별 매출 및 영업이익률



## ▼ 주요 내용

### [공통]

- 3Q24 매출액 1,301억원, 영업이익률 -3.8% 기록함
- 비용효율화 진행중이며 직전분기 대비 적자폭 개선
- 4Q23 이후 매출 턴어라운드 및 2분기 연속 유지

### [SMT]

- 3Q24 매출액 693억 기록함
- 중화권 주요 고객사 CAPEX 지연되며 매출 감소

### [그외 기타]

- 그 외 기타부문매출액 607억 기록함
- 공작기계(태양광설비) 매출 및 반도체장비(플립칩 본더) 매출 증가

# 연결재무제표 (3Q24)

(단위 : 억원)

구분	3Q24
자산	
유동자산	10,205
현금및현금성자산	2,794
파생금융상품	7
매출채권및기타채권	4,542
재고자산	2,634
기타유동자산	228
비유동자산	5,722
장기매출채권및기타채권	84
사용권자산	346
유형자산	2,896
무형자산	905
기타비유동금융자산	50
기타비유동자산	98
이연법인세자산	1,343
자산총계	15,926

(단위 : 억원)

구분	3Q24
부채	
유동부채	5,716
매입채무및기타채무	2,037
유동성차입금	2,786
미지급법인세	336
리스부채	241
기타유동부채	316
비유동부채	2,294
장기매입채무및기타채무	681
장기리스부채	127
종업원급여부채	1,249
이연법인세부채	237
부채총계	8,010
자본	
지배기업주주지분	7,885
자본금	252
자본잉여금	7,045
자본조정	- 39
기타포괄손익누계액	745
이익잉여금	-118
비지배지분	32
자본총계	7,917












## 2. APPENDIX

# APPENDIX (시큐리티 부문)






## Global Top-tier : Global Top 5, America Top 3

Global Market Share (\*중국시장제외)

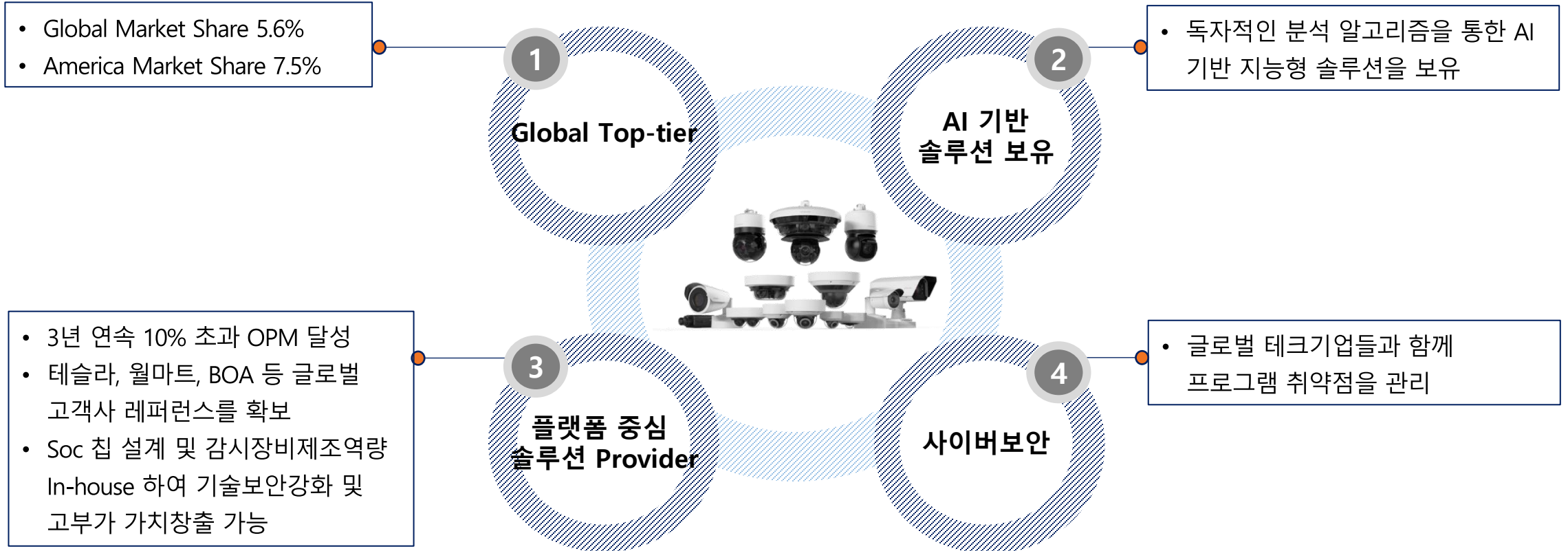
	'21년	'22년	'23년
 <b>HIKVISION</b>	15.8%	14.7%	14.2%
 <b>AXIS</b> COMMUNICATIONS	10.7%	10.9%	10.7%
 <b>MOTOROLA</b>	7.3%	7.5%	7.7%
 <b>ahua</b> TECHNOLOGY	9.0%	7.8%	7.0%
 <b>한화비전</b>	5.1%	5.7%	5.6%
 <b>BOSCH</b>	4.0%	3.8%	3.8%
 <b>PRO</b>	4.3%	3.8%	3.7%

\*Source: OMDIA

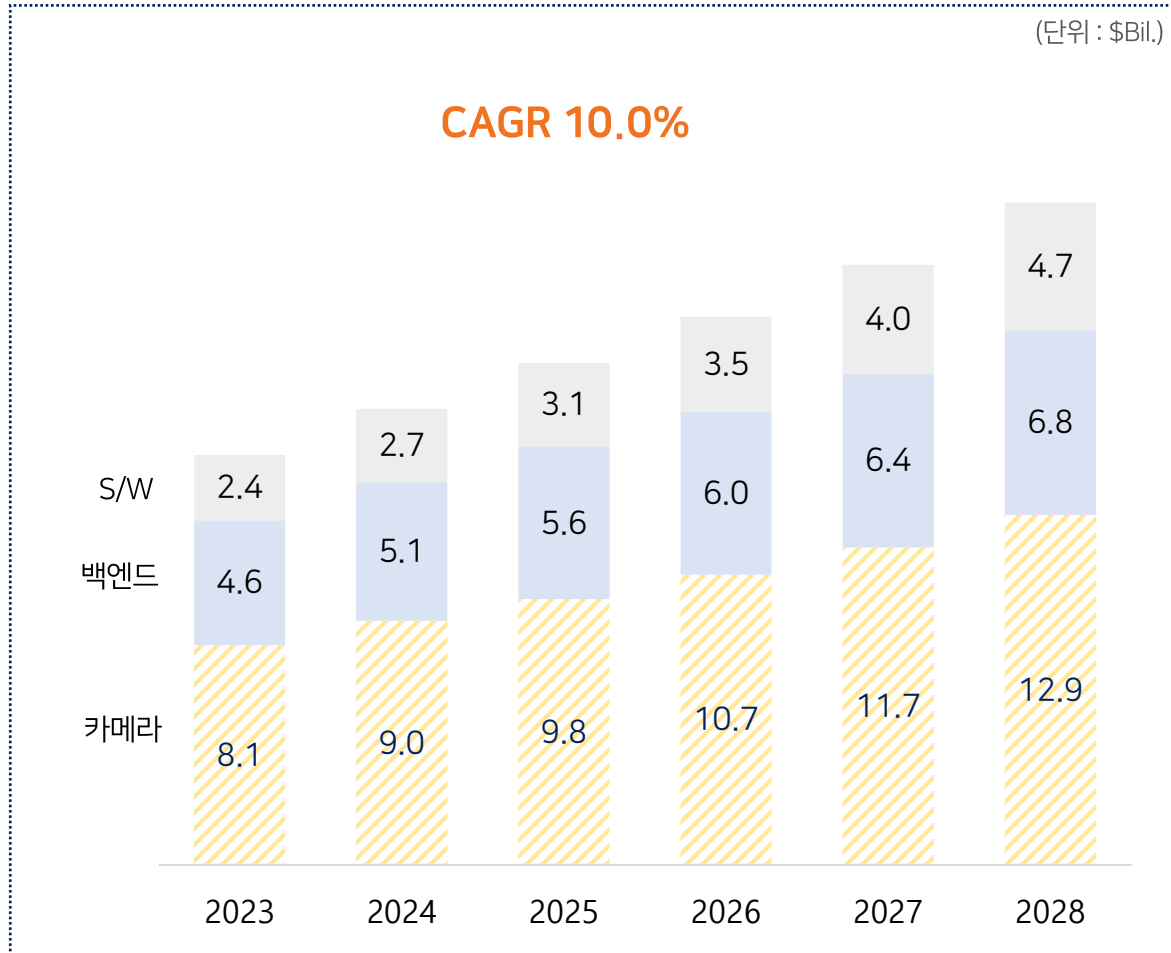
America Market Share

	'21년	'22년	'23년
 <b>AXIS</b> COMMUNICATIONS	13.9%	14.5%	14.1%
 <b>MOTOROLA</b>	11.5%	12.3%	12.2%
 Hanwha Vision	5.9%	7.6%	7.5%
<b>HIKVISION</b>	6.6%	5.6%	5.2%
<b>Genetec</b>	4.9%	4.4%	4.4%
 Verkada	N/A	N/A	4.3%
 <b>BOSCH</b>	4.6%	4.3%	4.2%

\*Source: OMDIA

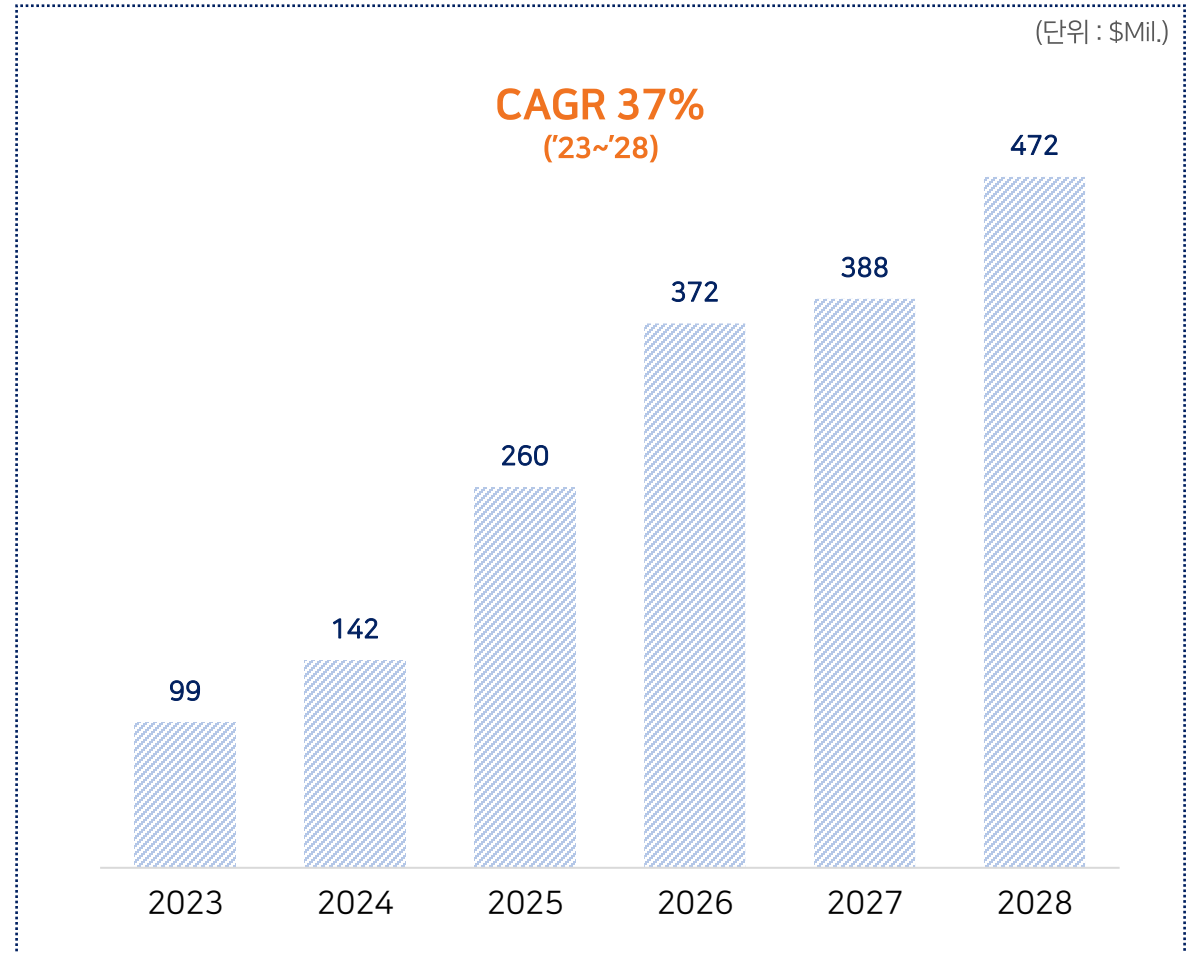


## 글로벌 보안시장 전망 (\*중국시장제외)



(출처 : OMDIA)

## Advanced Die Attach 시장

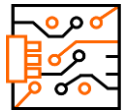


(출처 : Techinsights, June 2024)

## SMT

(Surface Mounting Technology)

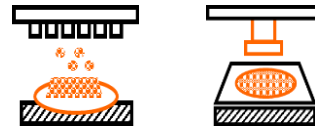
사업 연혁 35년



인쇄회로기판 (PCB)에 다양한 전자부품을 실장하기 위한, 초정밀 Pick & Place와 Vision Alignment 기술 및 최적화 S/W 솔루션, 주변기기 통합 인라인 솔루션을 보유

## 반도체 증착, 패키징

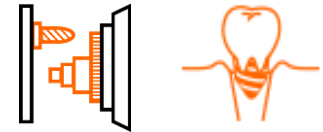
사업 연혁 15년 (기술 개발 31년)



고성능 반도체 제조를 위해 필요한 초미세 패터닝 증착 기술과 HBM에 필수인 Advanced Packaging을 위한 다양한 후공정 본딩 기술을 보유

## CNC 자동선반, 덴탈밀링

사업 연혁 47년



자동차 부품부터 의료용 부품까지 다양한 소재를 가공하는 초정밀 제어/가공 기술을 보유, 덴탈밀링까지 전방위 제조장비 라인업 구축



## SMT 글로벌 대형 고객 확보

수익 확대 및 성장성 확보를 위한 하이엔드 고속기,  
인라인 제조 솔루션 기반 사업 강화



## 반도체 대형사 레퍼런스 기반 사업 확대

국내 대형 고객과의 공동개발 및 평가를 바탕으로  
신기술과 시장을 선점하여, 글로벌 시장 공략



## 초정밀 가공 사업확대

공작기계의 기존 사업구조를 탈피하여,  
고수익 전망되는 의료기기 분야로 사업 확장



# Advanced Manufacturing Solution Creator

**E.O.D**